2.5D/3D集積化プロセスの開発動向と実装・材料・冷却技術の展望【LIVE配信】

1名分料金で2人目無料

◆日時:2025年3月4日(火)13:00～17:00
◆会場:自宅や職場など世界中どこでも受講可
◆聴講料 : 1名につき49,500円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。
・1名でお申込みされた場合、1名につき46,200円(税込)
・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料(2名で49,500円(税込))

セミナーお申込みFAX
０３－５８５７－４８１２
※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師 : 東京大学 システムデザイン研究センター(d.lab) 特任研究員 博士(工) 川野 連也 氏

【プログラム】※内容を省略して掲載しております。詳細はHPでご確認下さい。

1. はじめに －高密度実装の必要性－
   ・各種高密度パッケージの優劣比較
   ・チップレット解説

2. 高密度実装技術のアプリケーション
   高密度実装を要求する
   ・ロジックアプリケーション
   ・メモリアプリケーション
   ・イメージセンサアプリケーション
   とその要求仕様

3. 2.5D/3D異種機能集積(チップレット)を実現する
   パッケージ形態とベンチマーク
   ・Siインターポーザーを用いた2.5D/3D集積技術
   ・高密度配線基板を用いた2.xD/3D集積技術

4. 高密度実装のカギとなる
   ハイブリッド接合技術およびそのプロセス課題
   ・ハイブリッド接合のメカニズム
   ・ウェハレベルハイブリッド接合のプロセスフローと課題

5. 高密度実装に要求される材料技術
   ・放熱効率を支配する熱界面材料(TIM)
   ・狭ピッチバンプ接続のカギとなるアンダーフィル材料
   ・低温ハイブリッド接合を実現する銅めっき技術

6. 最先端実装に要求される冷却技術
   ・半導体パッケージの冷却技術概説
   ・シリコンチップを直接冷却するオンチップ冷却技術
   ・システム全体を冷却液に浸す液浸冷却技術

【LIVE配信セミナーとは？】
・本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードするか、Web ブラウザから参加するかの2種類がございます。
ZOOM WEBセミナーのはじめかた(http://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf)をご覧ください。
・お申込み後、受理のご連絡メールをさせていただきます。一部メールが通常セミナー形式(受講券、請求書、会場の地図)になっておりますが、LIVE配信のみのセミナーです。
・お申込み後、接続テスト用のURL(https://zoom.us/test)から「ミーティングテストに参加」を押していただき動作確認をお願いします。
・後日、別途視聴用のURLをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時の10分前に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
・セミナー資料は前日までには、お送りいたします。タブレットやスマートフォンでも視聴できます。

『半導体集積化【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住　所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E－Mail
①		
②		

会員登録(無料)　※案内方法を選択してください。複数選択可。 □Eメール　□ 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。
セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧下さい。
⇒ https://www.rdsc.co.jp/pages/entry

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧下さい。
⇒ https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy

R & D SUPPORT CENTER
株式会社Ｒ＆Ｄ支援センター
〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル7階
TEL) 03-5857-4811 FAX) 03-5857-4812 URL) https://www.rdsc.co.jp/